

**2022 年度上期 WEB 決算説明会（2023 年 2 月 14 日開催）****およびアナリストミーティングの主な質疑応答****【成長戦略・来年度以降見通し】****1. 業績予想の大幅修正となったが、従来の成長戦略・モノづくり力強化による利益率改善方針等に変更はないか？**

A: 今回は、パネル需要低下等に伴う FPD・マテリアルの受注減少、部品長納期化による売上進捗の遅れ、部材価格高騰などにより業績予想の修正を行ったが、半導体・電子等の中長期的投資拡大傾向に変わりなく、先端ロジック、パワーデバイス・各種電子デバイス、バッテリーなどの成長ドライバーで市場を上回る成長を継続していけると考えている。モノづくり力強化による利益率改善についても、足下は部品長納期化の影響で改善効果が減殺されているが、次期中期経営計画の中で再度、改善に取り組んでいく方針。

12 月末の受注残高は 1,361 億円で今年度末は 1,500 億円前後を見込んでおり、今後、売上高も段階的に増加、加えて半導体・電子の売上ウエイトも増加しミックスが改善、さらに部品長納期の緩和に伴い利益率改善効果も徐々に顕現化することで利益率も改善していく。

**2. 来年度（23 年度）の売上高・営業利益はどの程度を想定しているのか？成長するのか？**

A: 来年度の計画は 8 月に改めて説明するが、現段階では、期末受注残高 1,500 億円前後を見込んでおり、売上高は増加し、特に半導体電子が伸びることからミックスも更に改善し、売上高・営業利益ともに着実に増加すると考えている。

**3. 23 年 8 月に公表予定の次期中期経営計画では売上高 3,000 億円以上、売上総利益率 35%以上、営業利益率 16%以上を目指すとするが、来年度以降の売上高・利益（率）は本当に成長するのか？**

A: 半導体・電子等の中長期的投資拡大傾向に変わりなく、半導体電子を中心に市場を上回る成長を継続していくことで、来期以降も受注高・売上高の増加が見込める。

今年度末の受注残高は 1,500 億円前後の見込みであり、売上高増加による利益（率）改善が見込める。また、半導体電子の売上高増加によるミックス改善効果による利益（率）改善も見込める。

加えて、来期以降は部品長納期化の影響が徐々に緩和し、これまで取り組んできたモノづくり力強化の取組みの成果が少しずつ戻り現れてくることもあり、売上総利益率 35%以上、営業利益率 16%以上を達成していく。

**【上期実績・通期予想】****4. 通期業績予想の修正について、計画比売上高が 200 億円未達に対し営業利益が 105 億円未達の見込みとなっているがなぜか？**

A: FPD・マテリアル等の受注高減少（100 億円）および部品長納期化による売上貢献の遅れなどで計画比売上高が 200 億円未達見込みであることにより 80 億円程度の営業利益が未達となる。

加えて、部品長納期化の影響による生産性低下や原材料・部品価格高騰の価格転嫁までのタイムラグなどで利益率が下押しされる。販管費の削減に努めるが、営業利益は 105 億円計画を下回る見込み。

**5. 通期営業利益予想▲105億円の未達に対して当期純利益が▲30億円の未達見込みと未達額が少ないのはなぜか？**

A: 上期に為替損益が計画比プラスとなり、税金負担率も計画比低下したことで約30億当期純利益が上振れたことに加え、下期に計画外のグループ会社不動産売却益20億円、税金費用の計画比低下約20億円を見込んだため。

**6. 上期売上高が前年同期比57億円増加する一方、営業利益が9億円減少しているのはなぜか？**

A: 主に販管費が将来の成長のための開発関連を中心に21億円増加したため。

**7. 22年度の売上総利益率は21年度30.6%から30.9%へ改善を見込んでいるが、どのように改善できるのか？**

A: 相対的に利益率の高い半導体電子の売上高増加によるミックス改善効果による。

**8. 修正予想において、下期は上期に比べ売上高72億円、営業利益30億円、営業利益率2pt改善見込みとなっている理由を教えてください。**

A: 上期の受注残高は1,361億円となっており、特に利益率の高い半導体電子の受注残高が高まっており、今後、徐々に売上貢献度が高まってくるため、売上増加とミックス改善の両面で利益率が高めていくことを見込んでいる。

**9. 部品長納期化の影響を回避するための対応は？**

A: 部品長納期化への対応としては、引き続き、①必要な部品の早期手配、②サプライヤーとの納期交渉、③代替品・代替先への切替え、④出図遅れや発注遅れがないか、負荷状況と併せて、モニタリングなどの改善の手立てを取っている。また、部材高騰の販売価格への反映のタイムラグに対しては、部材価格の高騰を見積に確りと反映させて販売価格に反映していくようにしている。

モノづくり力強化への取組みは、部品長納期化・部材高騰の影響を受け、効果が減殺されている。当社はカスタマイズする装置が多いことがより影響を大きくしている構造的な問題もあり、装置事業においては、従来の受注生産型システムに加え、新たに計画生産型システムも導入していく方針。

**10. 上期のFPDおよび半導体電子部品の受注高・売上高の用途別内訳は？**

A: 別紙のとおり。

**11. 上期の営業利益率順位は？**

A: 別紙のとおり。

## 【半導体・電子 受注動向】

### 12. ロジック関連で市場を上回る受注の伸びとなっており、計画も上回っているがなぜか？

A: 先端ロジックの投資は若干遅れ気味であるが、ロジックの新工程参入・新規顧客への参入が今期から実現しており、前年同期比で 1.9 倍程度まで伸びる見込み。

5 ナノ・3 ナノ向け MHM 工程に加えて、今期から同じ TiN を使用するマスク以外の新工程参入が実現、また金属レイヤーの工程も 2Q に参入実現、他にも参入に向けてチャレンジしている新工程があり、今年度中には 4~5 工程程度の新工程参入を期待している。

また、今期から米国のレガシー分野への参入も実現するなど、来年度以降の投資拡大につながると考えている。

### 13. メモリ投資減速の影響は？投資回復はいつごろか？

A: メモリ投資減速で今期メモリ受注計画を 4 割弱下回る見込みとなっている。

メモリ投資の回復時期はメーカー各社が在庫調整に取り組んでいることから 23 年下期から年末にかけての回復を想定している。メモリ分野でも新工程参入のチャンスをもたらえるようになってきているのでこれを活かして、市場を上回る成長を実現していく。加えて、24 年以降は、米国等地域サプライチェーン構築のための最先端投資も活発化してくる。

### 14. 米国による中国半導体輸出規制等の影響は？

A: 今年度、受注を期待していた中国案件は 50 億円程度あり、計画を下回る可能性が高いと見ている。

中国ビジネスで成長を期待しているパワーデバイスや各種電子デバイスに関しては、米国の半導体規制の対象ではなく、好調な電子ビジネスが半導体の減少をカバーしている。

### 15. 電子部品の受注高はどの用途・地域が伸びたのか？

A: 電子部品関連の用途では、パワーデバイス・オプトデバイスを含む各種電子デバイスが増加している。

特にパワーデバイスの上期受注高は前年同期比で 2.3 倍、通期においても前年同期比 1.6 倍を見込んでいる。

AR/VR 用  $\mu$ OLED などオプトデバイスを含む各種電子デバイスの上期受注高は前年同期比で 1.6 倍、通期の前年同期比で 1.3 倍を見込んでいる。

### 16. パワーデバイスが好調だが、投資動向について教えてほしい。

A: 1Q に中国 SiC で 40 億円程度のスポット的な大型受注もあり、上期のパワーデバイスの受注は 170 億円程度となった。下期以降も日本・中国中心に高水準の受注が期待でき、年間では 270 億円弱程度の受注を見込む。

### 17. 電子の下期・来期以降はどのような見込みか？

A: パワーデバイス・オプトデバイス・各種電子デバイス等が日本・中国で投資拡大し、下期も好調に推移する見込み。

電子の年間受注は当初計画 510 億円を上回る 595 億円を見込む。今後は、グリーンエネルギー化・EV 化進展、中国の国産化政策等により、パワーデバイスの受注拡大は継続し、またスマート社会化・デジタル化 + メタバース・リモート活用拡大等に伴い、各種電子デバイスの受注拡大も継続すると見込んでいる。

## 【FPD 受注動向】

### 18. 来期以降の FPD 受注は 700 億～800 億円から 600 億前後になるとの説明だが、何が変わったのか？

A: スマートフォン・テレビなどの需要低迷でディスプレイの需要・価格も低下し、主要パネルメーカーの投資方針も慎重化、一部には投資時期がはっきりしていないものもあるため、来期以降の見込みを 700～800 億円から 600 億円前後に見直した。来期以降、IT パネル用大型基板 OLED のスパッタ装置やバッテリー用巻取蒸着装置中心に受注を見込むことに変わりない。  
半導体電子の市場を上回る成長で補っていく。

### 19. バッテリー関連投資が延期したとの説明だが、EV 用バッテリーの巻取蒸着装置はどのように伸びていくと考えられるか？

A: EV 用バッテリー向け巻取蒸着装置は量産技術確立に向けた開発が継続しており、来期にまとまった金額の受注を期待している。2Q には別の EV 用バッテリー関連メーカーより巻取蒸着装置の受注が実現し顧客層が広がった。EV 用フィルムキャパシター用巻取蒸着装置は、日本・中国の電子部品メーカーから継続的に受注見込み。来期は EV 用バッテリー向け巻取蒸着装置とフィルムキャパシター用巻取装置で 100 億オーダーの受注を目指すことに変わりない。

## 【その他】

### 20. 韓国に Technology Center を 60 億円で建設するということが、その目的、投資採算はどのように考えているのか？

A: 韓国の半導体メーカーは今後もロジック・メモリともに技術開発・投資を活発に行う。  
半導体メーカーの近くに Technology Center を建設することで、顧客と共同でのデバイス検証や量産技術開発の機会を増やし、製品開発を加速することでコラボレーションと技術サポートを強化し、半導体ビジネスの更なる強化を図っていく方針。  
すでに、セカンドベンダーとしての期待から、共同開発案件が増えてきているが、これを更に増やし、加速化させるには、顧客半導体メーカーの近くでパートナーとして共同開発に取り組むことが必要と判断した。  
24 年 3 月竣工予定であり、2 年程度で回収可能と考えている  
韓国アルバックと同工業団地内にあり、Technology Center へのデモ機移設により、既存工場の生産キャパアップも見込んでおります。

以上

## 別紙：品目別内訳割合・営業利益率順位

### ●受注高 品目別の内訳割合

受注高	FY2022 上期
<b>半導体電子（億円）</b>	<b>527</b>
・メモリ	1割半ば
・ロジック	2割弱
・電子部品	3割強
・パワー半導体	3割強
・実装	数%
・その他	-
<b>FPD（億円）</b>	<b>236</b>
・LCD	2割強
（大型向け割合）	（ほぼ大型向け）
・OLED	7割弱
・その他	約1割

### ●売上高 品目別の内訳割合

売上高	FY2022 上期
<b>半導体電子（億円）</b>	<b>366</b>
・メモリ	3割弱
・ロジック	1割半ば
・電子部品	3割弱
・パワー半導体	2割強
・実装	1割弱
・その他	-
<b>FPD（億円）</b>	<b>289</b>
・LCD	4割半ば
（大型向け割合）	（大型向け5割半ば）
・OLED	4割強
・その他	1割強

### ●営業利益率順位 FY2022 上期

順位	品目
1	半導体電子
2	コンポーネント
3	その他
4	一般産業
5	材料
6	FPD

全社平均利益率は

4) 一般産業と

5) 材料との間